

华创证券有限责任公司
关于
池州华宇电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

二〇二三年二月

声 明

作为池州华宇电子股份有限公司（以下简称“华宇电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“华创证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书的简称与《池州华宇电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人概况

(一) 发行人基本情况

中文注册名称	池州华宇电子科技股份有限公司
英文注册名称	Chizhou Hisemi Electronics Technology Co., Ltd.
注册资本	6,344.8097 万元
法定代表人	彭勇
有限公司成立日期	2014 年 10 月 20 日
股份公司成立日期	2020 年 12 月 30 日
住所	安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号
邮政编码	247099
联系电话	86-566-2818107
传真号码	86-566-2818016
互联网网址	http://www.hisemi.com.cn/
电子信箱	mengtao@hisemi.com.cn
信息披露和投资者关系	负责部门：证券法律部
	负责人：孟涛
	联系电话：86-566-2818107

(二) 发行人主营业务概况

公司主要从事集成电路封装和测试业务，主营业务包括集成电路封装测试、晶圆测试、芯片成品测试。公司总部设立于池州，在深圳、无锡、合肥设有子公司，有助于与全球客户保持紧密的技术合作关系并提供更高效的产业链支持。

目前，公司封装测试业务主要有 SOP、QFN/DFN、SOT、TO、LQFP 等多个系列，共计超过 100 个品种。自成立以来，公司始终专注于集成电路封装测试领域，坚持以技术创新为核心，已掌握多芯片组件（MCM）封装、三维（3D）叠芯封装、微型化扁平无引脚（QFN/DFN）封装、高密度微间距集成电路封装等核心技术，在集成电路封装测试领域具有较强的竞争实力。报告期内，公司封

装测试业务以封装+测试为主，部分情况下公司仅为客户提供封装服务，测试服务由客户自行完成或客户委托给其他专业测试厂商。

公司在测试领域形成了多项自主核心技术，测试晶圆的尺寸覆盖 12 吋、8 吋、6 吋、5 吋、4 吋等多种尺寸，包含 22nm、28nm 及以上晶圆制程；芯片成品测试方面，公司已累计研发出 MCU 芯片、ADC 芯片、FPGA 芯片、GPU 芯片、视频芯片、射频芯片、SoC 芯片、数字信号处理芯片等累计超过 30 种芯片测试方案；公司自主研发的 3D 编带机、指纹识别分选机、重力式测编一体机等设备，已在实际生产实践中成熟使用。

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	26,838.24	96.14%	53,972.27	95.82%	30,881.80	96.14%	21,319.40	95.65%
其他业务收入	1,077.78	3.86%	2,353.68	4.18%	1,238.79	3.86%	970.72	4.35%
合计	27,916.02	100.00%	56,325.95	100.00%	32,120.59	100.00%	22,290.12	100.00%

报告期内，公司的营业收入分别为 22,290.12 万元、32,120.59 万元、56,325.95 万元和 27,916.02 万元，各年主营业务集成电路封装测试的收入占比均超过 95%，公司主营业务突出。

（三）发行人主要财务数据及指标

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	106,376.65	94,005.96	55,522.14	28,492.05
归属于母公司的所有者权益（万元）	53,619.35	49,416.36	23,089.38	10,324.63
资产负债率（母公司）（%）	50.41	48.40	60.55	67.92
营业收入（万元）	27,916.02	56,325.95	32,120.59	22,290.12
净利润（万元）	3,417.24	13,163.13	6,132.86	3,543.83
归属于母公司所有者的净利润（万元）	3,417.24	13,163.13	6,132.86	3,543.83

项目		2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）		2,466.19	12,570.93	5,283.94	2,836.70
基本每股收益（元）	扣非前	0.54	2.22	1.21	0.71
	扣非后	0.39	2.12	1.04	0.57
稀释每股收益（元）	扣非前	0.54	2.22	1.21	0.71
	扣非后	0.39	2.12	1.04	0.57
加权平均净资产收益率（%）	扣非前	6.63	36.25	42.31	40.87
	扣非后	4.79	34.64	36.45	32.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）		7,232.29	11,389.90	9,608.02	4,404.50
现金分红（万元）		-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）		6.55	5.51	6.26	8.31

（四）发行人的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）以常规封装测试产品及中端专业测试平台为主，中高端封装测试及高端专业测试市场竞争力较弱的风险

报告期内，公司主要封装测试（含单独封装）业务收入和利润来源于 SOP、SOT、TO 等常规封测产品，主要专业测试收入和利润来源于中端专业测试平台，实现量产的中高端封测产品有 QFN/DFN、LQFP，高端专业测试平台实现的收入较少。公司常规封装测试产品实现的主营业务收入分别为 11,081.79 万元、16,600.29 万元、28,848.25 万元、15,529.25 万元，占当期封装测试（含单独封装）业务收入的比例分别为 98.07%、91.40%、80.61%、82.96%；公司中端测试平台产品实现的主营业务收入分别为 9,918.04 万元、12,221.21 万元、15,867.76 万元、6,096.67 万元，占当期专业测试业务收入的比例分别为 98.98%、96.08%、87.27%、75.08%。

受公司在先进封装测试技术方面的研发投入和人才储备限制，公司在 FC、BGA、WLCSP、SiC/GaN 等先进封装测试领域的产品设计及生产工艺等与国内

外领先企业存在较大的技术差距，公司的产品结构、产品应用领域、市场占有率也因此受限，公司在先进封装测试产品市场的竞争力相对较弱。

根据 Yole 相关预测，从 2019 年至 2025 年，全球半导体封装测试市场的营收将以 4% 的年复合增长率增长，而先进封装测试市场将以 6.6% 的年复合增长率增长，市场规模到 2025 年将增长至 420 亿美元，高于传统封装测试市场 1.9% 的年复合增长率。随着半导体行业进入后摩尔时代对先进封装测试的依赖也逐渐增加，如果未来公司无法开发出满足市场需求的先进封装测试形式产品，将导致公司产品结构扩充受限、核心竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(2) 业绩及毛利率下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 37.80%、36.70%、40.49%、29.77%，其中封装测试(含单独封装)业务毛利率分别为 28.80%、25.32%、32.03%、23.56%，专业测试毛利率分别为 47.96%、52.94%、57.13%、44.09%。公司封装测试产品主要应用于消费电子等领域，受国内疫情及俄乌战争等的影响，2022 年以来，手机、笔记本电脑等终端产品需求放缓，公司产品价格出现下调，销售收入增速下降；2021 年度公司加大了固定资产投资并新增了较多的人员，固定资产折旧及人力成本大幅攀升。由于终端应用领域需求放缓，公司订单增速低于产能增长率，使得公司 2022 年 1-6 月产能利用率下降，相应的公司 2022 年 1-6 月主营业务毛利率出现较大幅度的下降，净利润出现较大幅度的下滑。从目前情况来看，公司产品主要应用领域消费电子市场需求可能难以在短期内快速回升，公司销售订单增速可能进一步放缓甚至下滑，产品毛利率水平可能进一步下滑，公司面临一定的经营业绩下滑风险。

(3) 原材料价格波动风险

公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、键合丝(金丝、铜线、合金线等)和装片胶。2019 年至 2022 年 1-6 月，公司主营业务成本中直接材料占比分别为 29.25%、31.31%、36.60%、35.35%，占比较高，原材料价格的波动会对公司的毛利率产生较大影响。2020 年下半年以来，公司原材料如引线框架、装片胶、部分键合丝供给价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响存在一定程度的上涨，若未来公司原材料价格持续上涨，而公司产品售价不能及时调整，

则原材料价格上涨将对公司的盈利能力造成不利影响。

(4) 生产用工短缺及人力成本上升风险

集成电路封装测试行业属于人才密集型和劳动密集型企业，尤其是对熟练的一线生产工人需求量较大。报告期内，公司业务规模快速扩张，生产用工人数量亦随之快速增长，截至各报告期末公司员工人数分别为 669 人、855 人、1,147 人和 1,427 人。

充足稳定的劳动力供应是公司扩大生产经营规模的必备条件，但随着中国逐步步入老龄化社会，劳动人口的数量呈现负增长和劳动力短缺的趋势，相应地导致了生产用工短缺，加速推动了人力成本的上升。此外，公司主要经营地之一的安徽省池州市虽然具备一定的集成电路产业基础，但对生产人员特别是具备一定技术的熟练技术工人缺乏足够的吸引力。公司未来如果不能保持或及时招聘到足够的技术工人或者人力成本大幅上升，将会对公司的生产效率和经营规模的扩大产生不利影响。

(5) 进口设备依赖的风险

报告期内，公司因市场需求增长、国内进口替代等因素进行了产能扩张，固定资产投资规模呈现快速增长趋势。截至 2022 年 6 月末，公司固定资产中机器设备原值为 70,643.73 万元。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括东京精密、DISCO、KS、ASM 等国际知名设备厂商。公司进口设备主要应用于晶圆减薄、切割、键合等生产工序，对于公司的生产经营至关重要。

截至本上市保荐书签署之日，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备尚未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备及其生产技术的出口管制力度和范围，如公司现有进口设备出现使用受限的情形，将对公司生产经营造成较大不利影响。

(6) 华力宇现有生产经营场所存在被拆迁的风险

2021 年 12 月 7 日，深圳市宝安区城市更新和土地整备局发布了关于《黄田社区土地整备利益统筹项目（二期）实施方案》的公告，黄田社区土地整备利益统筹项目（二期）实施方案已经宝安区土地整备指挥部 2021 年第 5 次会议、宝

宝安区城市更新工作委员会 2021 年第 7 次会议审议通过。项目位于宝安区航城街道，已纳入市 2021 年城市更新和土地整备计划。公司全资子公司华力宇目前所租赁的厂房正处于上述更新区域，目前具体实施时间和计划尚未公告，华力宇存在生产经营场所被拆迁的风险。

(7) 应收账款回收风险

公司报告期各期末应收账款净额分别为 4,435.59 万元、6,380.31 万元、7,069.94 万元、7,041.00 万元，占当期流动资产的比例分别为 31.97%、29.86%、21.57%、21.98%，占比较高。公司通过了一系列的制度、措施用于加强应收账款的回收管理，报告期内，公司账龄 1 年以内应收账款占应收账款余额的比例均在 97% 以上。未来随着公司募投项目的达产以及业务规模的扩大，应收账款的金额可能会进一步增加，如果未来公司重要客户出现信用风险而导致大额应收账款无法按期收回或者无法收回的情形，将对公司业绩造成重大不利影响。

(8) 存货跌价风险

尽管公司的生产模式主要根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织生产，为了应对主要原材料价格波动，同时考虑原材料交付周期因素，公司通常会根据市场行情预测订单需求情况备用一定的安全库存。公司报告期各期末存货净额分别为 1,896.37 万元、3,234.69 万元、6,987.86 万元、8,100.19 万元，占当期流动资产的比例分别为 13.67%、15.14%、21.32%、25.28%，存货占流动资产的比例较高且呈较快增长趋势。报告期各期末，公司计提存货跌价准备余额分别为 13.87 万元、17.68 万元、86.87 万元、409.26 万元。若市场环境发生重大变化导致出现主要原材料价格大幅波动、下游客户存在重大延期或违约等情形，公司将承担存货跌价的风险。

(9) 税收优惠政策变化风险

报告期内，公司享受的税收优惠主要为高新技术企业所得税税率优惠和研发费用加计扣除所得税优惠。公司 2018 年被认定为高新技术企业，2021 年通过了高新技术企业资格复审，报告期内享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠。

全资子公司华力宇 2019 年度为符合减免税条件的小型微利企业，2020 年被

认定为高新技术企业，2020年度、2021年度享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

全资子公司无锡华宇光微2019年度、2020年度为符合减免税条件的小型微利企业，2021年被认定为高新技术企业，享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

全资子公司合肥华达2018年被认定为高新技术企业，2019年度及2022年1-6月为符合减免税条件的小型微利企业。

全资子公司华宇福保2018年被认定为高新技术企业，2021年度及2022年1-6月符合小型微利企业税收政策。

2019年4月1日至2021年12月31日，全资子公司无锡华宇光微符合增值税加计抵减规定的条件，上述期间享受可抵扣进项税额加计抵减10%的优惠政策；2021年1月1日至2022年6月30日，全资子公司华力宇符合增值税加计抵减规定的条件，上述期间享受可抵扣进项税额加计抵减10%的优惠政策。

报告期内，公司享受的研发费用加计扣除、高新技术企业所得税、小型微利企业税收优惠及增值税加计抵减税收优惠合计金额为620.20万元、662.42万元、1,508.31万元和1,028.06万元，占剔除股份支付影响后的当期利润总额的比例分别为15.40%、9.28%、9.75%和22.54%。报告期内，公司享受的税收优惠政策在一定程度上提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化，或者公司及子公司未能持续获得高新技术企业认定，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（10）政府补助变化风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为771.24万元、1,018.68万元、626.12万元和1,133.48万元，占剔除股份支付影响后的当期利润总额的比例分别为19.15%、14.28%、4.05%和24.85%。若未来公司不能获得政府补助或者获得的政府补助大幅减少，会对公司的经营业绩造成不利影响。

（11）募集资金投资项目新增产能消化风险

本次募集资金将用于池州先进封装测试产业基地建设项目、合肥集成电路测

试产业基地大尺寸晶圆测试及芯片成品测试项目、池州技术研发中心建设项目及补充流动资金，其中池州先进封装测试产业基地建设项目、合肥集成电路测试产业基地大尺寸晶圆测试及芯片成品测试项目为扩产项目。本次募集资金投资项目达产后将新增封装测试产能 7.92 亿只/年，其中 QFN 新增封装测试产能 7.2 亿只/年，LGA 新增封装测试产能 0.72 亿只/年，新增晶圆测试产能 45.60 万片/年，芯片成品测试产能 12 亿只/年。

虽然公司已经通过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托公司未来的产品竞争力、市场开拓能力、集成电路封测市场发展情况以及下游终端市场的环境等，具有一定的不确定性。在未来募投项目实施过程中，若市场环境、竞争对手策略、公司市场开拓等方面出现重大不利变化，或市场增长情况不及预期，或行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，则将会对公司募投项目的产能消化产生不利影响。

(12) 资产折旧增加的风险

随着本次募投项目的建成投产，公司固定资产规模相应增加，资产折旧金额也随之加大。根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成达产后产生的新增年折旧费用为 3,172.71 万元，每年预计新增折旧金额占公司 2021 年收入的比重为 5.63%，占 2021 年利润总额的比重为 21.14%，对公司业绩影响较大。若募集资金投资项目不能按照计划达产并实现经济效益，将在一定程度上影响公司净利润和净资产收益率水平。

(13) 研发失败的风险

随着半导体行业进入后摩尔时代，半导体行业正越来越重视封装测试技术的发展，行业技术升级速度的加快要求企业必须加大研发投入。企业需要根据不断变化的市场需求，持续地投入大量的资金和人员对现有产品进行升级并持续开发新产品。如果未来公司在研发立项时未能充分论证或判断有误，在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临研发项目失败的风险，产品创新不能满足市场需求或符合行业发展方向导致客户流失、业绩下滑，而前期的研发投入难以收回将对公司经营业绩产生不利影响。

(14) 研发技术人员紧缺及流失的风险

公司所处的集成电路封测行业属于技术、人才密集型行业，技术研发人员是公司研发活动和技术创新的基础，是保持技术优势的核心因素。随着集成电路封装测试行业规模的快速增长和市场竞争的不断加剧，企业对人才的竞争将愈加激烈。如果公司不能提供有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以稳定核心技术团队以及引进优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失及紧缺的风险，将对公司的持续研发能力造成不利影响，进而影响公司的业绩表现。

(15) 环保风险

集成电路封装过程涉及到多种化学工艺，会产生以废水、废气为主的污染物，尤其是电镀环节产生的工业废水中包含易溶于水的有害物质，重金属含量高，需要企业配备专业污水处理措施。环保问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准提高导致公司环保投入增加的可能。此外，若在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件对环境造成污染或者触犯环保方面法律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。

(16) 核心技术失密风险

经过公司研发团队多年的努力和积累，公司拥有了一项核心技术。目前，公司与核心技术人员均签订了《劳动合同》并约定了保密和竞业禁止条款，核心研发成果也申请了专利保护。但是公司目前还有多项核心技术尚处于研发过程中，如果出现核心研发技术人员离职或者离职后没有遵守约定的保密和竞业禁止义务的情形，公司将面临核心技术失密的风险。

(17) 劳务派遣用工风险

报告期内，公司存在劳务派遣用工的情形，其中 2019 年、2020 年，子公司华力宇及无锡华宇光微使用被劳务派遣人员数量超过其用工总量的 10%。截至目前，公司劳务派遣用工人数符合《劳务派遣暂行规定》的相关要求。若公司在未来的生产经营过程中未能有效控制劳务派遣用工人数的占比，则公司劳动用工的

合法性将会产生瑕疵，对公司经营业务的开展带来不利影响。

(18) 社保、住房公积金补缴风险

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社保、住房公积金的情形，因而公司存在为员工补缴社保、住房公积金的风险，可能对公司生产经营带来一定的不利影响。

(19) 规模扩张带来的经营管理风险

报告期内，公司资产总额分别为 28,492.05 万元、55,522.14 万元、94,005.96 万元和 106,376.65 万元，营业收入分别为 22,290.12 万元、32,120.59 万元、56,325.95 万元和 27,916.02 万元，资产规模和经营业绩都增长迅速。公司通过多年的持续发展，已建立起与公司业务相匹配的经营管理体系。本次公开发行股票后，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、业务规模、员工数量将进一步扩充，对于公司的内控体系、生产管理、财务管理等方面均提出了更高的要求。如果公司不能及时调整、完善组织结构和管理体系以适应公司规模快速扩张，将对公司的生产经营带来不利影响。

(20) 内控制度建设和执行的风险

出于业务发展和规范管理的需要，公司已根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，逐步建立了符合上市公司要求的内部控制体系。上述制度及体系的实施时间较短，如果公司的内控制度不能根据公司发展规模及时予以调整、完成，或者内控制度不能有效地贯彻和落实，将影响公司内部控制的有效性。

2、与行业相关的风险

(1) 技术及产品升级迭代风险

公司所处的集成电路封装测试行业具有封装测试技术多样、技术及产品更新速度快的特点，尤其是近年来随着云计算、物联网、大数据等新业态的出现并快速发展，集成电路应用终端呈现小型化、智能化的发展趋势，我国集成电路的技术水平、产品结构等也紧跟终端系统产品的趋势，推动了集成电路封装测试技术

向大功率、高密度、高频率、高可靠性、高能效和小型化、薄型化的方向演变。

上述发展趋势也对公司的封测技术升级、产品迭代提出了更高的要求，如果公司不能对封测产品的应用领域和终端市场进行准确的判断，快速识别并响应客户需求的变化，在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入并推出具有竞争力的新产品，公司可能因无法开拓新的产品和业务而导致客户流失、市场占有率降低，逐渐丧失市场竞争力从而对公司的生产经营造成重大不利影响。

(2) 行业需求波动风险

集成电路封装测试行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性，其波动幅度甚至会超过宏观经济波动幅度。同时，近年来国内集成电路行业受中美贸易战以及国外疫情产能紧缺的影响，国产替代空间巨大，推动了国内集成电路需求的高速增长。

如果未来宏观经济波动较大或长期处于低谷，或者国际政治经济环境变化，亦或是国外疫情得到有效控制产能得以恢复，国内半导体行业的景气度也将随之受到影响而产生较大波动，公司经营业务增速可能放缓甚至出现下滑，进而导致公司经营业绩出现波动。

2022 年以来，全国疫情多点散发，北上广等一线城市及长三角、京津冀等区域接连受到疫情影响，多地区采取集中隔离、居家隔离、封控区和管控区管理等措施，叠加大众消费信心下滑、消费延迟、换机意愿降低等因素导致智能手机、笔记本电脑等消费电子产品出货量下降，影响产业链相关企业。如未来下游消费类电子领域不能企稳回升甚至进一步下滑，则可能导致公司经营业绩无法企稳回升甚至进一步下滑。

(3) 市场竞争加剧风险

随着下游终端市场的快速增长和国内替代趋势的加速，国内集成电路封装测试需求持续稳定增长，同时国家也加大了对半导体行业的政策扶持力度，近年来社会各界对集成电路封装测试行业的资金和资源投入也不断增加，行业潜在或新进入者数量也在增加，使得市场竞争愈发激烈。如果公司未来不能在产品研发、工艺改进、产品质量、市场开拓等方面提升自身优势和竞争力，将可能导致公司

因市场竞争加剧导致市场占有率下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(4) 收入季节性风险

2019 年度至 2021 年度，公司一季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为 14.70%、14.92%、18.61%，2022 年第一季度公司实现主营业务收入 12,985.53 万元，占 2022 年 1-6 月主营业务收入的比例为 48.38%，略低于其他季度，公司主营业务收入存在一定的季节性波动。公司封装测试产品主要用于智能家居、消费类电子、工业控制等领域，每年的第四季度和次年的第一季度属于该等终端产品的需求旺季，但由于次年的第一季度节假日较长，公司客户会选择提前在第四季度备货，导致一季度的销售量相对较少。因此，受下游终端客户的需求影响，公司销售收入存在季节性波动的风险。

3、其他风险

(1) 实际控制人不当控制风险

本次发行前，彭勇、高莲花、赵勇、高新华分别持有公司 34.03%、25.81%、13.40% 和 3.99% 的股份，彭勇、赵勇和高新华通过华宇芯管理间接持有公司 0.13% 股份；彭勇担任华宇芯管理的普通合伙人，通过华宇芯管理间接控制公司 3.37% 的股份，彭勇、高莲花、赵勇、高新华签署了《一致行动人协议》，为公司的共同控股股东和实际控制人，合计控制公司 80.60% 的股份。同时彭勇担任公司董事长、总经理，高莲花担任公司董事，赵勇、高新华担任公司董事、副总经理。本次发行完成后，彭勇、高莲花、赵勇、高新华仍将控制本公司 60.45% 的股份（假设公司公开发行新股 2,115 万股，且未进行老股转让），彭勇、高莲花、赵勇、高新华仍将为公司实际控制人，处于绝对控股地位。未来如果上述共同实际控制人不能很好的约束自身行为，利用其控制地位对公司的重大事项予以不当控制或者施加不当影响，将可能损害公司及其他股东的利益，也不利于公司的持续发展。

(2) 股价波动风险

股票二级市场价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受股票供需关系、国家宏观经济状况、国家政策、投资者的心理预期以及其他多

种因素的影响，也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动，因此公司存在股价下跌的风险。

(3) 发行失败风险

公司本次申请首次公开发行股票，发行结果除将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况的影响外，还会由于投资者对行业和公司理解存在偏差以及受投资偏好的影响，使得投资者对公司股票发行价格及股价的未来趋势认知不一样。如果公司的价值和前景不能得到投资者认可而导致后续发行环节出现发行认购不足，则会导致公司面临发行失败的风险。

(4) 新型冠状病毒肺炎疫情风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情给社会经济发展带来了不利影响，尽管目前我国防控形势持续向好，但全球疫情尚存在较大不确定性。公司封装测试产品主要应用于智能家居、消费类电子、工业控制等领域，新冠疫情也会对下游终端需求带来一定程度的影响。

截至本上市保荐书签署之日，新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动未构成重大不利影响。若后续新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内未得到有效控制持续蔓延，国内疫情出现反复，宏观经济环境继续恶化，公司封装测试产品的终端应用领域需求也可能因此减少，从而对公司经营业绩产生不利影响。

二、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 2,115 万股	占发行后总股本比例	不低于发行后总股本的 25%
其中：发行新股数量	不超过 2,115 万股	占发行后总股本比例	不低于发行后总股本的 25%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	不超过 8,459.8097 万股		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元（按照【】年	发行前每股收益	【】元（按照【】

	【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)		年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【】元(按照【】年【】月【】日经审计的归属母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)	发行后每股收益	【】元(按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次发行采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、行政法规禁止购买者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	池州先进封装测试产业基地建设项目		
	合肥集成电路测试产业基地大尺寸晶圆测试及芯片成品测试项目		
	池州技术研发中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	合计【】万元;其中保荐及承销费用【】万元,审计、评估及验资费用【】万元,律师费用【】万元,信息披露、发行手续费、材料制作费及其他【】万元		
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	无		

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

(一) 保荐代表人

华创证券有限责任公司指定孙翊斌和万静雯为本次发行的保荐代表人。

孙翊斌：保荐代表人，现任华创证券投资银行一部执行总经理，具备非执业注册会计师、非执业注册税务师资格，工商管理硕士。2006年起从事与投资银行业务相关的上市公司及IPO审计工作，担任过山航B、闽灿坤B、奥特迅、深国商、广聚能源、华谊嘉信年报审计会计师以及华谊嘉信、兆日科技IPO申报会计师；2012年3月起从事投资银行业务，分别参加了湖南空港实业股份有限公司、长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票申报工作，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份购买资产、浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股份、气派科技科创板IPO等投资银行业务项目。

万静雯：保荐代表人，现任华创证券投资银行一部高级副总监，金融硕士，具备非执业注册会计师资格；曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部和西南证券投资银行部。曾参与捷捷微电创业板IPO、捷捷微电非公开发行股票、捷捷微电向不特定对象发行可转债、气派科技科创板IPO等保荐承销项目。

(二) 项目协办人及其他项目组成员基本情况

华创证券有限责任公司指定黄永圣千为本次发行的项目协办人。项目组的其他成员有危唯、陈熠、胡万昕、王江、胡道、林敏祺、吴烨、孙靖东、楼奕颖。

黄永圣千：华创证券投资银行一部高级经理，会计硕士。曾参与建科集团拟IPO上市项目、气派科技科创板IPO项目，具备较强的财务基础和丰富的项目经验。

(三) 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座20层华创证券

联系人：孙翊斌、万静雯

联系电话：0755-88309300

传真：0755-21516715

四、保荐人与发行人的关联关系

经核查，截至本上市保荐书签署日，发行人与保荐机构之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形，具体说明如下：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的股份；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方的股份、在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在互相提供担保或融资的情形；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系的情形。

第二节 保荐机构承诺事项

一、保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

二、保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十五条所列相关事项，在上市保荐书中做出如下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

（九）自愿遵守证监会规定的其他事项。

三、保荐人承诺已对本次证券发行上市发表明确的推荐结论，并具备相应的

保荐工作底稿支持。

四、保荐机构承诺，将遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

一、本次发行已履行的决策程序

发行人就首次公开发行股票并在主板上市事宜履行的内部决策程序如下：

（一）董事会

2022年3月25日，发行人召开了第一届董事会第九次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》等与本次发行及上市相关的各项议案。

（二）股东大会

2022年4月9日，发行人2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》等与本次发行及上市相关的各项议案。

二、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：发行人上述董事会、股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》等的规定，并已依法定程序作出决议，上述决议的内容合法、有效；华宇电子申请首次公开发行股票并在主板上市已履行了必要的内部决策程序。

三、保荐机构关于发行人是否符合主板定位及国家产业政策的说明

本保荐机构查阅了发行人出具的《关于符合主板定位要求的专项说明》，获取并查阅了《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等文件，与发行人高级管理人员访谈，对发行人生产经营场所进行实地走访观察，获取并检查发行人与客户签订的业务合同、订单、产成品出库单、销售发票、序时账、科目余

额表、财务报表等资料，查阅了容诚会计师事务所出具的审计报告，对发行人的财务指标进行复核计算，查阅了同行业可比公司年报、官网及招股说明书等公开披露文件。经核查，保荐机构认为：

发行人主营业务为半导体集成电路封装测试，按照国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下面的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业。发行人所属行业为国家重点发展和大力支持的产业，主要产品和业务发展方向符合我国半导体行业政策导向。发行人所属行业符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定。

发行人具备良好的业务基础，业务模式成熟，经营业绩稳定。报告期内，2019年至2021年，发行人经营业绩呈稳健增长趋势。2022年上半年，发行人营业收入保持稳定，盈利能力有所下滑，主要系受2022年以来消费电子终端需求放缓，收入增速下降叠加固定资产折旧及人力成本大幅攀升所致。发行人2022年1-6月的经营业绩与同行业可比公司变动趋势不存在重大差异。

发行人属于国家统计局大型企业，业绩满足《上市规则》所规定的“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”第一套企业市值及财务指标要求。发行人作为国内规模中等的集成电路封装测试第二梯队企业，具备较强的技术实力和完整的品质管控体系，SOP、SOT、QFN/DFN等主要封装产品市场竞争力与国内领先企业同类产品基本相当，具有行业代表性。

综上，保荐机构对发行人是否符合主板定位及国家产业政策进行了尽职调查和审慎核查，并出具了《关于池州华宇电子股份有限公司符合主板定位要求的专项意见》，认为发行人符合主板定位及国家产业政策。

四、保荐机构关于发行人符合《上市规则》规定的上市条件的说明

发行人股票上市符合《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市

规则》规定的上市条件：

（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件

1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明

本保荐机构对发行人是否符合《证券法》关于首次公开发行新股条件的情况进行了逐项核查。经核查，本保荐人认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件，具体情况如下：

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构

本保荐机构查阅了发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、历次股东大会、董事会、监事会决议、会议记录及相关制度文件，实地考察了发行人各部门的经营运作，确认发行人已具有完善的公司治理结构，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会各专门委员会等制度，建立健全了内部经营管理机构和相应的内部管理制度，相关机构和人员能够依法履行职责，公司治理规范有效，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

（2）发行人具备持续经营能力

本保荐机构查阅了会计师事务所出具的发行人最近三年一期的审计报告等财务资料、发行人最近三年一期的经营情况、发行人正在履行的重大业务合同等资料，发行人财务状况良好，营业收入和净利润表现出了较好的成长性，具备持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人最近三年一期财务会计报告出具了无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

本保荐机构对相关政府部门进行了访谈，查阅了公安机关、检察院、法院等

政府机构的网络公开信息，取得了相关政府部门出具的守法证明，确认发行人及其控股股东、实际控制人最近三年一期不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

（5）发行人符合中国证监会规定的其他条件

经核查，本保荐机构认为发行人符合中国证监会对股份公司首次公开发行股票并上市所规定的其他资格条件，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（五）项之规定。

2、本次证券发行符合《首发注册管理办法》规定的发行条件的说明

本保荐机构根据《首发注册管理办法》对发行人及本次发行的相关条款进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为，本次证券发行符合《首发注册管理办法》规定的发行条件。本保荐机构的具体核查意见如下：

（1）发行人符合《首发注册管理办法》第十条的规定

经核查发行人设立至今的工商登记资料、创立大会文件、发起人协议、历次三会协议以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司治理文件，保荐机构认为：

1) 发行人前身华宇有限成立于2014年10月20日，发行人系由华宇有限以2020年10月31日为基准日按原账面净资产值整体变更设立的股份有限公司并取得统一社会信用代码为91341700394369432D的企业法人营业执照，截至目前仍依法存续。发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

2) 发行人已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等工作制度，选举了董事会、监事会成员并在公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，制定了相应的实施细则，明确了权责和决策程序，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员均能够依法履行职责。

(2) 发行人符合《首发注册管理办法》第十一条的规定

经核查本次发行的审计机构容诚会计师出具的《审计报告》和《内部控制鉴证报告》、发行人的原始财务报表及内部控制相关凭证和文件等资料，保荐机构认为：

1) 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年一期财务会计报告由容诚会计师出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z3968号）。

2) 发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，根据容诚会计师出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2419号），发行人于2022年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

(3) 发行人符合《首发注册管理办法》第十二条的规定

自设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

1) 经核查发行人的主营业务经营情况、主要资产、商标、专利、著作权等资料，查阅发行人报告期内的关联交易相关资料，实地核查有关情况，并结合发行人董事、监事和高级管理人员填写的调查表等，保荐机构认为：

公司系由华宇有限整体变更设立。设立时，公司整体承继了华宇有限的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司独立于股东的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，该等资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严

重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2) 经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售、采购合同及主要客户、供应商等资料,以及发行人工商资料、历次董事会和股东会(或股东大会)决议、聘任文件、工商登记资料等文件,保荐机构认为:

发行人自成立以来专注于集成电路封装测试业务,公司主营业务、控制权和管理团队稳定,最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;发行人的股份权属清晰,最近三年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

3) 经核查发行人主要资产权属资料、企业信用报告、诉讼或仲裁资料等相关文件资料,取得了相关政府主管部门开具的无违法违规证明,通过网络检索发行人相关信息,以及取得发行人的相关声明等,保荐机构认为:

发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

(4) 发行人符合《首发注册管理办法》第十三条的规定

经核查发行人营业执照、公司章程、主要业务合同,查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策,实地查看了发行人生产经营场所,取得了工商、税务、社保、公积金、海关、外汇等方面的主管机构出具的有关证明文件;核查了发行人实际控制人、董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录证明,进行公开信息查询,并取得发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的调查表及出具的声明等,保荐机构认为:

1) 发行人的经营活动符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,符合国家产业政策;

2) 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为;

3) 发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

综上所述,保荐机构认为,发行人本次证券发行符合《首发注册管理办法》规定的发行条件。

(二) 发行后股本总额不低于五千万元

本次发行前发行人股本总额为 6,344.8097 万元。本次发行拟公开发行新股数量不超过 2,115 万股,发行后总股本不超过 8,459.8097 万股。

经核查,本次发行后,发行人股本总额不低于人民币 5,000 万元。

(三) 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过四亿元的,公开发行股份的比例为10%以上

本次发行前发行人总股本为 6,344.8097 万股,本次发行拟公开发行新股数量不超过 2,115 万股,占本次发行后总股本的比例不低于 25%。

经核查,本次公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上。

(四) 市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

依据《上市规则》等相关法律法规,发行人选择具体上市标准如下:“(一)最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6,000 万元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元”。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润分别为 3,543.83 万元、6,132.86 万元、13,163.13 万元和 3,417.24 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 2,836.70 万元、5,283.94 万元、12,570.93 万元和 2,466.19 万元;最近三年累计净利润为 22,839.82 万元,累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 20,691.57 万元;发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 4,404.50

万元、9,608.02 万元、11,389.90 万元和 7,232.29 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为 25,402.42 万元；发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月营业收入分别为 22,290.12 万元、32,120.59 万元、56,325.95 万元和 27,916.02 万元，最近三年累计营业收入为 110,736.66 万元。

经核查，发行人财务指标符合《上市规则》规定的标准。

（五）深圳证券交易所要求的其他条件

经核查，发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述，本保荐人认为，发行人符合《上市规则》规定的上市条件。

五、持续督导工作安排

主要事项	工作安排
（一）持续督导事项	股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度对发行人进行持续督导。
督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理办法》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	1、督导发行人严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； 2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。
持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；	1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； 2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机

主要事项	工作安排
	构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；	1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理制度》等制度，规范对外担保行为； 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项； 3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
(二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	发行人已在保荐协议中承诺积极配合保荐机构的现场检查工作以及参加保荐机构组织的培训等，不得无故阻碍保荐机构正常的持续督导工作。
(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、发行人已承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料，并确保公司高管人员尽力协助保荐机构进行持续督导； 2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐工作。

六、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他需要说明的事项。

七、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论

根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首发注册管理办法》《上市规则》等有关规定，华创证券对发行人进行了必要的尽职调查，并与发行人、发行人律师、发行人审计机构经过充分沟通后，认为：发行人具备了《证券法》《首发注册管理办法》《上市规则》等法律法规规定的申请首次公开发行股票并在主板上市的各项条件，同意推荐发行人证券发行并在深圳证券交易所主板上市，并承担相关保荐责任。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于池州华宇电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书》之签署页）

保荐机构法定代表人、董事长： 陶永泽
陶永泽

保荐机构总经理： 陈强
陈强

保荐业务负责人： 杨锦雄
杨锦雄

内核负责人： 高瑾妮
高瑾妮

保荐代表人： 孙翊斌
孙翊斌

万静雯
万静雯

项目协办人： 黄永圣千
黄永圣千

